

单晶硅片

N型-YSG210-Res0.4-A级



单线生产能力大幅提升



能耗物耗大幅降低



质量行业领先

全面的产品及体系认证

- ISO 9001:2015 质量管理体系
- ISO 14001:2015 环境管理体系
- ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系

单晶硅片规格书

N型-YSG210-Res0.4-A级

关键参数

导电类型	N型	P/N型测试仪 (DLY-2P/N)
掺杂元素	Ga.(镓)	--
电阻率/ $\Omega\cdot\text{cm}$	0.4-1.1	硅片自动检测设备
少子寿命/ μs	≥ 70	准稳态光电导衰减法/瞬态光电导衰减法 注入水平: 1E15cm(Sinton BCT-400)
间隙氧含量/at/cm ³	$\leq 8.0 \times 10^{17}$	傅里叶变换红外光谱仪 (ASTM F121-83)
替位碳含量/at/cm ³	$\leq 5.0 \times 10^{16}$	傅里叶变换红外光谱仪 (GB/T 1588-2009)

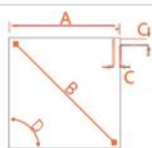
材料性能

生长方式	直拉法	--
结晶性	单晶	择优化学腐蚀法 (ASTM F47-88)
错位密度/PCS/cm ²	≤ 500	X射线衍射仪 (ASTM F26-1987)
表面晶向/ $^\circ$	$\langle 100 \rangle \pm 3$	X射线衍射仪 (ASTM F26-1987)
侧面晶向/ $^\circ$	$\langle 010 \rangle, \langle 001 \rangle \pm 3$	X射线衍射仪 (ASTM F26-1987)

几何尺寸及表面性能

硅片型号	YSG210	--
几何外形	全方	--
倒角边形状	圆弧	--
硅片边距/mm	210 ± 0.25	硅片自动检测设备
硅片直径/mm	$\phi 295 \pm 0.25$	硅片自动检测设备
垂直度/ $^\circ$	90 ± 0.15	硅片自动检测设备
厚度/ μm	135 ± 10 150 ± 10	硅片自动检测设备
批次厚度/ μm	≥ 155 ≥ 130	硅片自动检测设备
TTV/ μm	≤ 25	硅片自动检测设备
线痕/ μm	≤ 15	硅片自动检测设备
弯曲度/ μm	≤ 40	硅片自动检测设备
翘曲度/ μm	≤ 40	硅片自动检测设备
切割方式	金刚线切割	--
表面质量	表面洁净, 无可见污染 (无油污、指印、花斑、砂浆残留、配液量)	硅片自动检测设备
崩边	深度 $\leq 0.33\text{mm}$ & 长度 $\leq 0.55\text{mm}$, 不超过1个/片, 无V型崩边	人工检验或硅片自动检测设备
隐裂/气孔	不允许	硅片自动检测设备

硅片尺寸示意图



Size: G12
 A: $210 \pm 0.25\text{mm}$
 B: $\phi 295 \pm 0.25\text{mm}$
 C: $1.41 \pm 0.45\text{mm}$
 D: $90 \pm 0.15^\circ$

北京远鹏新能源科技有限公司

☎ 010-65777288

📍 北京市朝阳区朝阳北路财经路252号

No.252 Finance Road, Chaoyang North Road,
Chaoyang District, Beijing

🌐 www.yoposolar.com

✉ sales@yoposolar.com



企业官网
Corporate Website



企业微信平台
Enterprise wechat